

# EMIシールドペースト〈半導体PKG〉

半導体パッケージ等の表面に直接塗布！

## 用途

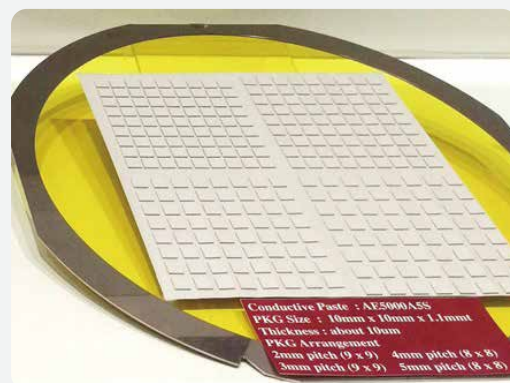
### 半導体パッケージ向けシールド用途

スプレー塗布機を使用し、半導体パッケージ表面に塗布。その後硬化させることで、10 $\mu$ m程度のシールド層を形成します。直接塗布できることから、余分な空間の発生を抑制。軽薄短小化する機器に対応します。

塗布・硬化後イメージ



塗布・硬化後イメージ



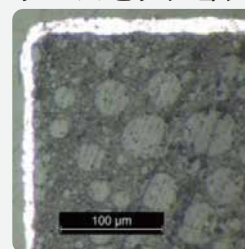
## 特徴

- 80dBを超える優れたシールド特性
- モールド、ガラス基材への高密着性
- PKGのグランド接続高信頼性

PKG塗布表面



クロスセクション



## ラインナップ&特性

製品型番		AE5000A5-12GS	AE5000Wシリーズ<代表値を記載>
タイプ		高密着タイプ	薄膜タイプ
粘度	E型 10rpm※	mPa·s	200±100
硬化条件	予備硬化	100°C×10分	
	本硬化	170°C×50分	150°C×50分
体積抵抗率[代表値]		$\Omega \cdot \text{cm}$	
		5.0E-05	2.0E-05

※ コーンプレート型粘度計 CP-40 10rpm

